

半导体展会- 预定展位,先订先得-2024年半导体材料展会招展"火爆"进行中!

产品名称	半导体展会-预定展位,先订先得-2024年半导体材料展会招展"火爆"进行中!
公司名称	中国(耀瀚)展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日 展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规模超60,000m²，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示Mini/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众到场参观。SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会为半导体产业带来了一个展示、交流创新理念、拓展市场、培养人才的盛会。在未来，我们期待半导体产业能够不断创新，为人类社会的科技进步和美好生活做出更大贡献。

参展企业来自全球多个国家和地区，届时众多品牌亮相，展示前沿产品与技术及创新解决方案，半导体博览会是企业开拓半导体市场的平台，以半导体产业为主题的交流、采购大会，半导体博览会将引领西安半导体行业不断突破升级。2024展会期间计划举办半导体行业的现场精彩活动。

在人才培养方面，SEMI-e2024也充分发挥了其行业盛会的作用。通过举办一系列技术研讨、培训活动，展览会为半导体产业培养了大量人才。这些人才将成为推动产业发展的重要力量，为半导体产业的未来注入新的活力。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

- 3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等
- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会的成功举办，不仅为半导体产业提供了一个展示、交流创新理念的平台，也为推动产业发展、加强国际合作发挥了重要作用。相信在未来，随着半导体技术的不断发展和创新，我们将迎来更加美好的科技生活。

展览会期间，与会者纷纷表示，SEMI-e2024为半导体产业带来了无限机遇和挑战。一方面，随着全球科技的不断进步，半导体作为支撑各行业发展的核心基础，其市场需求将持续增长。另一方面，随着技术的日新月异，半导体产业正面临着一系列技术难题和市场挑战，需要不断创新和突破。